

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成19年12月20日(2007.12.20)

【公開番号】特開2001-203076(P2001-203076A)

【公開日】平成13年7月27日(2001.7.27)

【出願番号】特願2000-338454(P2000-338454)

【国際特許分類】

H 05 B 33/04 (2006.01)

H 05 B 33/10 (2006.01)

H 01 L 51/50 (2006.01)

【F I】

H 05 B 33/04

H 05 B 33/10

H 05 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成19年11月6日(2007.11.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】発光装置の作製方法

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

絶縁体の上の複数箇所に一部開口部を有し、かつ少なくとも発光素子を囲むように第1のシール材を形成し、

前記第1のシール材を介して前記絶縁体にカバー材を接着し、

前記開口部が露呈するように、前記絶縁体の一部、前記カバー材の一部および前記シール材の一部を分断し、

前記絶縁体、前記カバー材および前記第1のシール材で囲まれた部分に充填材を注入し、

前記絶縁体に比べて前記カバー材の面積が小さくなるように、前記絶縁体の一部および前記カバー材の一部を分断することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項2】

絶縁体の上の複数箇所に一部開口部を有し、かつ少なくとも発光素子を囲むように第1のシール材を形成し、

前記第1のシール材を介して前記絶縁体にカバー材を接着し、

前記開口部が露呈するように、前記絶縁体の一部、前記カバー材の一部および前記シール材の一部を分断し、

前記絶縁体、前記カバー材および前記第1のシール材で囲まれた部分に充填材を注入し、

前記絶縁体に比べて前記カバー材の面積が小さくなるように、前記絶縁体の一部および前記カバー材の一部を分断し、

前記絶縁体の上に接続端子を取り付け、

前記第1のシール材の露呈部および前記接続端子の一部に接して第2のシール材を形成することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項3】

請求項1又は請求項2において、

前記絶縁体、前記カバー材および前記第1のシール材で囲まれた部分に充填材を注入する際に、真空注入法を用いることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項4】

絶縁体の上の複数箇所に少なくとも発光素子を囲むように第1のシール材を形成し、前記発光素子の上に充填材を滴下し、

前記第1のシール材を介して前記絶縁体にカバー材を接着し、

前記絶縁体に比べて前記カバー材の面積が小さくなるように、前記絶縁体の一部および前記カバー材の一部を分断することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項5】

絶縁体の表面の複数箇所に少なくとも発光素子を囲むように第1のシール材を形成し、前記発光素子の上に充填材を滴下し、

前記第1のシール材を介して前記絶縁体にカバー材を接着し、

前記絶縁体に比べて前記カバー材の面積が小さくなるように、前記絶縁体の一部および前記カバー材の一部を分断し、

前記絶縁体の上に接続端子を取り付け、

前記第1のシール材の露呈部および前記接続端子の一部に接して第2のシール材を形成することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項6】

請求項1乃至請求項5のいずれか一において、

前記第1のシール材を形成する前または後に前記絶縁体の上にスペーサを散布することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項7】

請求項1乃至請求項6のいずれか一において、

前記充填材として樹脂を用いることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項8】

請求項1乃至請求項7のいずれか一において、

前記充填材に吸湿性物質を添加することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項9】

請求項1乃至請求項8のいずれか一において、

前記発光素子としてEL素子を用いることを特徴とする発光装置の作製方法。